CATALYZER CVD DEVICE

Publication number: JP6338491 Publication date: 1994-12-06 Inventor: HIGUCHI HISASHI Applicant: KYOCERA CORP

Classification:

- international:

841J2/385; C23C18/44; C23C16/455; G03G5/08; H01L21/205; H01L21/31; H01L31/04; B41J2/385; C23C16/44; C23C16/455; G03G5/08; H01L21/02; H01L31/04; (IPC1-7): H01L21/31; B41J2/385; C23C16/44; G03G5/08; H01L21/205; H01L31/04

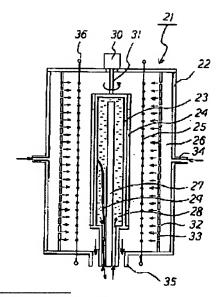
- European:

Application number: JP19930126848 19930528 Priority number(*): JP19930126848 19930528

Report a data error here

Abstract of JP6338491

PURPOSE:To provide a catalyzer CVD device for an electrophotography photosensitive body having excellent mass-producibility which can form an a-Si film having an excellent film quality on a cylindrical base body, and which can at one time form the a-Si film on a plurality of planar base bodies or cylindrical base bodies. CONSTITUTION:Inside a container 22 having a gas flow hole 32 on as inner peripheral surface, a cylindrical heat catalyzer 25 and a base body supporter 23 having respectively large or small diameters are so arranged that their center axes are almost aligned with each other, and also the heat catalyzer 25 is so structured that gas permeates the catalyzer 25 and a film-forming base body 24 is provided on the outer peripheral surface of the base body supporter 23 and basic body temperature setting means is provided inside.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-338491

(43)公開日 平成6年(1994)12月6日

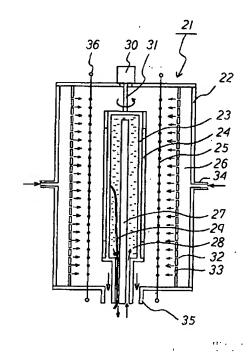
(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/31 B 4 1 J 2/385	識別配号 庁内整理番号 C	FI			技術表示箇所
C 2 3 C 16/44	В				
·		B 4 1 J	3/ 16	101	
	7376-4M	H01L	31/ 04	v	
	審査請求	未請求 請求項	質の数4 OL	(全 20 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平5-126848	(71)出願人	000006633	社	
(22)出願日	平成5年(1993)5月28日				井ノ上町5番地
		(72)発明者	滋賀県八日市	市蛇滯町長谷! 会社滋賀工場	野1166番地の 6

(54) 【発明の名称】 触媒CVD装置

(57)【要約】

【目的】 円筒状基体に良好な膜質のa‐Si系膜を形成できる、電子写真感光体用の触媒CVD装置を提供する。また、一度に複数個の平板状基体または円筒状基体にa‐Si系膜を形成できる、量産性に優れた電子写真感光体用の触媒CVD装置を提供する。

【構成】 内周面にガス吹き出し孔32を有する容器22の内部に、それぞれ大小の径を有する筒状の熱触媒体25と基体支持体23とを中心軸がほぼ同一となるように配設すると共に、上記熱触媒体25をガスが透過する構造と成し、上記基体支持体23の外周面に被成膜用基体24を設け且つ内側に基体温度設定手段を付設して成ることを特徴とする触媒CVD装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 内周面にガス吹き出し孔を有する容器の 内部に、それぞれ大小の径を有する筒状の熱触媒体と基 体支持体とを中心軸がほぼ同一となるように配設すると 共に、上記熟触媒体をガスが透過する構造と成し、上記 基体支持体の外周面に被成膜用基体を設け且つ内側に基 体温度設定手段を付設して成る触媒CVD装置。

中心部にガス吹き出し手段を有する容器 【請求項2】 の内部に、それぞれ大小の径を有する筒状の基体支持体 と熱触媒体とを中心軸がほぼ同一となるように配設する 10 と共に、上記熟触媒体をガスが透過する構造と成し、上 記基体支持体の内周面に被成膜用基体を設け且つ外側に 基体温度設定手段を付設して成る触媒CVD装置。

【請求項3】 中心部にガス吹き出し手段を有する容器 の内部に、それぞれ大小の径を有するように同心円状に 配列した複数の基体支持体と筒状の熱触媒体とを中心が ほぼ同一となるように配設すると共に、上記熱触媒体を ガスが透過する構造と成し、上記複数の基体支持体の外 周面に被成膜用基体を設け且つ内側に基体温度設定手段 を付設して成る触媒CVD装置。

【請求項4】 平板状のガス吹き出し手段を有する容器 の内部に、該ガス吹き出し手段とほぼ平行となるように 平板状の熱触媒体と直線状に配列された複数の基体支持 体とを順次並設すると共に、上記熱触媒体をガスが透過 する構造と成し、上記複数の基体支持体の外周面に被成 膜用基体を設け且つ内側に基体温度設定手段を付設して 成る触媒CVD装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、触媒CVD法によって 30 基体上にアモルファスシリコン系の薄膜を形成するため の、触媒CVD装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、アモルファスシリコン(以下、a Siと略す)系の材料を用いた電子写真感光体や太陽 電池、イメージセンサ、光センサ、TFT(薄膜トラン ジスタ)等の製作には、主にグロー放電プラズマCVD 法による成膜装置が広く用いられてきた。このグロー放 電プラズマCVD法による成膜装置でa-Si電子写真 感光ドラムを製作する場合には、図20に示すようなグ ロー放電プラズマCVD装置1が用いられる。同図はそ の装置1の概略構成図であって、円筒状の真空容器2の ほぼ中央に配置した円筒状の導電性基体上に、グロー放 電プラズマによりa-Si系膜を成膜するものである。 これによれば、基体支持体3に保持された導電性基体4 を接地電極とし、これを等距離で囲んだ中空の円筒状の 金属電極を、高周波電力印加電極5とする。電極5に は、成膜用の原料ガスを導入するガス導入管6が接続さ れており、電板5の内周面に設けられたガス吹き出し孔

グ8、8、が設けられ、電極5と基体4との間には、高 周波電源9が接続されている。支持体3の内部には、二 クロム線やカートリッジヒーターなどからなる基体加熱 手段10が設けられていて、基体4を所望の温度に設定 することができる。また、支持体3と基体4は、回転用 のモーター11と回転伝達手段12により、一体で回転 させることができ、膜厚や膜質の均一化を図っている。 この装置を用いてa-Si系膜の成膜を行なうに当たっ

る。電極5の上下には、接地との絶縁のための絶縁リン

ては、所定の流量やガス比に設定された原料ガスを、ガ ス導入管6からガス吹き出し孔7を介して両電極間に導 入すると共に、真空ポンプ(図示せず)に接続された排 気配管13からの排気量を調整することにより、所定の ガス圧力に設定する。その後、高周波電源9により高周 波電力を印加して、両電極間にグロー放電プラズマを発 生させて原料ガスを分解し、所望の温度に設定した基体

4上にa-SI系膜を成膜する。

【0003】しかしながら、上記のグロー放電プラズマ CVD法では、成膜中のa-Si系膜の表面がプラズマ 20 によりダメージを受けるため、膜特性の向上や積層膜の 界面特性の制御に限界があるという問題点があった。ま た、成膜装置毎にグロー放電プラズマ発生用の高価な高 周波電源が必要であるという問題点もあった。さらに、 高周波によるグロー放電プラズマの発生に伴って、電力 の一部が髙周波ノイズとして成膜装置の各部や外部に漏 洩し、ガス流量やガス圧力あるいは基体温度の各種制御 機器の誤動作を引き起こすという問題点もあった。

【0004】加えて、プラズマによる分解生成物は、真 空容器内の基体以外の部位、すなわち電極や容器の内 壁、排気配管系等にも付着し堆積する。そのため、a-Si系膜の成膜中に副生成物として黄色の易燃性粉体が 多量に発生し、その粉体が成膜中の基体表面に飛来し て、成膜欠陥の発生原因となっていた。また、成膜毎に 反応炉内の粉体洗浄作業を必要とし、しかもその取扱い に危険が伴うという問題点もあった。

【0005】これらの問題点に対処し、a-Si系膜の 特性を改善することを目的として、近年、特開昭63-40 314 号、特開昭63-234514号、特開昭63-234515号、特 開平2-224227号、特開平 3-239320号等に、触媒CV D法と呼ばれる成膜方法およびその装置が提案されてい

【0006】この触媒CVD装置を、図19に示す装置 の概略図に基づいて説明する。東空容器からなる反応室 14内には、基体の保持と加熱が可能な基体保持台15 が設置され、その上面に基体16が保持される。基体1 6の上部には、適当な間隔をおいてタングステン等から なる熱触媒体17が配置され、その熱触媒体17を通過 して基体上に原料ガスを供給出来るように、ガス導入管 18が配設される。19は真空ポンプ、20は基体加熱 7から、基体4に向けて両電極間に原料ガスが導入され 50 手段としてのヒーターである。この装置によりa-Si

40

系膜を成膜するには、真空ポンプ19により真空状態に 排気した反応室14内に、S1H4とH2の混合ガスな どからなる原料ガスをガス導入管18より導入し、1000 ~1400℃に加熱された熱触媒体17を通過させて触媒反 応を起こさせ、その反応により分解生成した反応生成物 を基体16上に到達させて、a-Si系膜を堆積させ る。

【0007】この触媒CVD法によれば、成膜反応にお いてプラズマによるダメージがないため、優れた特性の 膜が得られ、積層膜の界面特性も良好となる。また、a 10 -Si:H膜中の水素含有量の低減が可能となることに よりa-Si:H膜の光学的パンドギャップが小さくな るために、太陽電池の光電変換効率が向上し、太陽電池 やイメージセンサにおける光劣化が改善され、TFTで のキャリア移動度が改善されるなどの利点を有する。

[0008]

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、上記 各提案の装置においては平板状の被成膜基体であり、そ の他の基体形状、例えば電子写真感光ドラムとして使用 されていなかった。

【0009】そこで、本発明者が円筒状基体に触媒CV D法により成膜形成したところ、装置の構成上、成膜に 際して高温に加熱された熱触媒体を基体の近くに配置す るため、基体が熱触媒体からの輻射熱により加熱され、 基体温度の制御が困難になるという問題点があることが 判明した。このような問題点は、平板状基体を用いても 同様に提起されている。 すなわち、特開平 3-239320号 には、高温の触媒部材からの輻射熱による基体の加熱を 防止するための、気体が通過可能な輻射遮断部材を設け 30 ることが開示されている。そこで、本発明者が上記公報 の提案に基づいて、輻射遮断部材を設けた円筒状基体用 触媒CVD装置を各種試作したところ、基体加熱の防止 効果は得られたが、その反面、輻射遮断部材にも成膜 し、これに伴ってガスの利用効率が低下するという問題 が生まれた。しかも、基体上の膜厚を質子写真感光体と して必要な数十μmまで厚くするために成膜時間を長く した場合、輻射遮断部材に成膜した膜が応力のために剥 がれて基体に飛来し、基体上の膜に成膜欠陥を発生させ るという問題点もあった。加えて、円筒状基体に成膜す る際には、その基体の外周面にわたって均等に原料ガス が供給されることが必要であり、それに応じた触媒CV D装置は提案されていなかった。

【0010】本発明は上記の問題点を解決して完成され たものであり、その目的は、輻射遮断部材を設けなくて も基体温度を所定の範囲に設定できるとともに、原料ガ スの利用効率を高めることができる、高品質のa-Si 系膜を用いた電子写真感光ドラムを作製するための、触 媒CVD装置を提供することにある。

[0011]

【問題点を解決するための手段】本発明の請求項1に係 る触媒CVD装置は、内周面にガス吹き出し孔を有する 容器の内部に、それぞれ大小の径を有する筒状の熱触媒 体と基体支持体とを中心軸がほぼ同一となるように配設 すると共に、上記熱触媒体をガスが透過する構造と成

し、上記基体支持体の外周面に被成膜用基体を設け且つ 内側に基体温度設定手段を付設して成ることを特徴とす る。

【0012】本発明の請求項2に係る触媒CVD装置 は、中心部にガス吹き出し手段を有する容器の内部に、 それぞれ大小の径を有する筒状の基体支持体と熱触媒体 とを中心軸がほぼ同一となるように配設すると共に、上 記熱触媒体をガスが透過する構造と成し、上記基体支持 体の内周面に被成膜用基体を設け且つ外側に基体温度設 定手段を付設して成ることを特徴とする。

【0013】また、本発明の請求項3に係る触媒CVD 装置は、中心部にガス吹き出し手段を有する容器の内部 に、それぞれ大小の径を有するように同心円状に配列し た複数の基体支持体と筒状の熱触媒体とを中心がほぼ同 される円筒状基体に適した装置については、十分に開示 20 一となるように配設すると共に、上記熱触媒体をガスが 透過する構造と成し、上記複数の基体支持体の外間面に 被成膜用基体を設け且つ内側に基体温度設定手段を付設 して成ることを特徴とするものであり、量産に適した触 媒CVD装置である。

> 【0014】更に、本発明の請求項4に係る触媒CVD 装置は、平板状のガス吹き出し手段を有する容器の内部 に、そのガス吹き出し手段とほぼ平行となるように平板 状の熱触媒体と直線状に配列された複数の基体支持体と を順次並設すると共に、上記熱触媒体をガスが透過する 構造と成し、上記複数の基体支持体の外周面に被成膜用 基体を設け且つ内側に基体温度設定手段を付設して成る ことを特徴とするものであり、量産に適した触媒CVD 装置である。

[0015]

【実施例】以下、本発明の触媒CVD装置につき、実施 例に基づいて詳細に説明する。

[例1] 図1は本発明の請求項1に係る触媒CVD装置 21の概略構成図であり、この図に対して2通りの構成 を示す横断面図を図2または図3に示す。この装置21 は、筒状の真空容器22のほぼ中央に配された円筒状も しくは多面体状の基体24上に、熱触媒体25を介して ガス吹き出し手段26から原料ガスを供給し、触媒CV D法によってa-Si系の膜を成膜するものである。

【0016】真空容器22は、基体24のセットや取り 出しが出来るように、容器の一部、例えば上蓋が開閉可 能に形成される。23は基体支持体であり、その内部に 加熱手段27と冷却手段28と温度検出手段29とが設 けられていて、支持体23に装着される基体24の成膜 時の温度を制御する。また、支持体23には回転伝達手

50 段31を介して基体回転用のモーター30が接続されて

おり、成膜中に支持体23と基体24とが一体に回転される。ガス吹き出し手段26は、多数のガス吹き出し孔32を設けた内周面33を有し、この内周面33と真空容器22とにより、中空状に形成されており、ガス導入管34を介して原料ガスが導入される。35は、図示しない真空ポンプに接続されたガス排気配管である。容器22には、この他に真空度をモニターする圧力計(図示せず)も接続されている。

【0017】この装置21で用いる基体24の形状は、 円筒状もしくは平板状であり、平板状基体を用いる場合 10 には、図3に示すように複数個の基体をほぼ円筒状ある いは多面体状になるように基体支持体上に配置して、成 膜を行なう。

【0018】基体24の材質は、製品の用途に応じて、 導電性または絶縁性あるいは絶縁性基体の表面に導電処 理を施したものが選択される。導電性基体としては、例 えば、アルミニウム(A1)、ステンレススチール(S US)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、銅(Cu)、チタン(Ti) 等の金属またはこれらの合金が挙げられる。

【0019】絶縁性基体としては、ホウ珪酸ガラスやソ ーダガラス、パイレックスガラス等のガラスや、セラミ ックス、石英、サファイヤ等の無機絶縁物、あるいはフ ッ素樹脂、ポリカーポネート、ポリエチレンテレフタレ ート、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、 ポリスチレン、ポリアミド、ピニロン、エポキシ、マイ ラー等の合成樹脂絶縁物が挙げられる。これらの絶縁性 基体は、必要に応じて、少なくとも成膜を行なう側の表 面が導電処理される。この導電処理は、絶縁性基体の表 面にITO(インジウム・スズ・酸化物)、酸化錫、酸 30 化鉛、酸化インジウム、ヨウ化銅等の導電層や、A1、 Ni、金(Au)等からなる金属層を、真空蒸着法、活 性反応蒸着法、イオンプレーティング法、RFスパッタ リング法、DCスパッタリング法、RFマグネトロンス パッタリング法、DCマグネトロンスパッタリング法、 熱CVD法、プラズマCVD法、スプレー法、塗布法、 浸渍法等で形成することで行なう。

【0020】基体21を保持する基体支持体23の形状は、触媒CVD装置21のように真空容器の中央に配置される場合、円筒状基体を保持する際には図2のように円筒状とし、平板状基体を保持する際には図3のように断面を多面体状とする。

【0021】この基体支持体23の内部には、熱触媒体 25からの輻射熱を受けても成膜中の基体温度を所望の 値に維持するために、温度検出手段29と加熱手段27 と冷却手段28からなる基体温度制御手段を設ける。温 度検出手段29としては、熱電対やサーミスタ等を用い て支持体23の外壁の温度を検出するように取り付け、 外壁を介して支持体23に保持された基体24の温度状 態をモニターしながら、温度調節器(図示せず)により 50 み合わせて、筒状とする。

加熱手段27と冷却手段28を制御して、基体温度を所望の値に維持する。加熱手段27には、ニクロム線やシーズヒーター、カートリッジヒーター等の電気的なものや、油等の熱媒体が用いられる。冷却手段28には、空気や窒素ガス等の気体や、水、油等からなる冷却媒体が、基体支持体23内部を循環するようにして用いられる。この基体温度制御手段により、成膜中の基体温度は、100~500℃、好適には200~350℃の一定温度に制御される。

【0022】更に、支持体23は回転軸を備えており、容器22との接点には装置内部の真空を維持しつつ基体 温度制御手段を機能させる回転機構が設けられる。このような回転機構としては、回転軸を二重もしくは三重構 造としてオイルシールやメカニカルシール等の真空シー ル手段を用い、中空にした回転軸内部に温度検出手段や ヒーターの配線および媒体の循環経路を設ける。内部の 配線や媒体の循環経路と外部の制御機器との接続には、 スリップリングや回転導入端子等を用いる。

【0023】基体支持体23を回転させる回転伝達手段 31は、上記のように基体温度制御手段を内蔵した支持 体23の回転軸を兼ねたもの、または図1に示したよう に、支持体23の軸とは反対側に回転伝達のみを行なう 軸を設けたものとする。あるいは、支持体23の下側に 基体温度制御手段を内蔵した回転軸を、上側に回転を支 持する軸を設けて、基体回転の位置精度を高めるように する。これらの機構により、基体表面の全面にわたっ て、一様な膜厚分布や膜特性が確保できる。

【0024】本発明の触媒CVD装置で用いる熱触媒体 25の材料としては、原料ガスの少なくとも一部に触媒 反応あるいは熱分解反応を起こして、その反応生成物を 堆積種となし、かつ触媒材料自身が、昇華や蒸発により 堆積される膜中に混入しにくいものが選択される。

【 0 0 2 5】 このような材料には、タングステン (W)、白金 (Pt)、パラジウム (Pd)、モリブデン (Mo)、Ti、ニオブ (Nb)、タンタル (Ta)、コパルト (Co)、Ni、Cr、Mnやそれらの合金がある。

【0026】熱触媒体25の基本的な形状は、基体21 あるいはガス吹き出し手段26をほぼ等距離で取り囲む ような、基体24より大きな径の筒状であり、ガスが透 過する構造を有している。その成形法には、例えば以下 のような方法がある。

【0027】①上記の材料で作られたワイヤーやフィラメント、リポン等を、セラミックスや石英、タングステン等の支持材を格子状や網目状、メッシュ状、ハニカム状等に組み合わせた筒状支持体に巻き付け、筒状とする。

②上記の材料で作られたワイヤーやフィラメント、リボン等を、格子状や網目状、メッシュ状、ハニカム状に組み合わせて、筒状とする。

③上記の材料で作られた薄い平板に、円形や三角形、正 方形、長方形、菱形、六角形、縦長のスリット状、横長 のスリット状、斜めのスリット状、またはそれらの組合 せからなる種々の通気孔を多数設けたものを、筒状に成 形する。

④③のような通気孔を設けた、直径の異なる複数の筒状 平板を、互いの通気孔が重ならず、かつ互いの筒状平板 間にガスの通過する間隙を有するように、二重以上に組 み合わせる。

【0028】上記のような熱触媒体25の形状の例を、図4の(a)~(m)に部分図で示す。同図(a)~(c)は、上記①の熱触媒体材料36を支持材37に巻き付けた例、同図(d)~(f)は、上記②の熱触媒体材料36を組み合わせた例、同図(g)~(k)は、上記③の熱触媒体材料で作られた平板38に種々の通気孔39を多数設けた例、同図(1)、(m)は、上記④の例を示すものである。

【0029】これらの熱触媒体25には、真空容器22 の外部から電流端子36を介して電力が供給され、通電 によるジュール熱で500~2000℃、好適には80 20 0~1400℃の高温に加熱される。

【0030】熱触媒体25の位置は、基体支持体23に保持された基体24とほぼ等距離の間隔を有するように、中心軸がほぼ同一となるように配置される。基体との間隔は、生成された堆積種の基体への効率的な輸送や、熱触媒体からの輻射熱による基体や堆積膜の損傷防止などの点から設定され、3~100mm、好適には5~50mm、最適には10~40mmとされる。

【0031】成膜用原料ガスを供給するガス吹き出し手段26は、熱触媒体25を介して基体24とは反対側に 30 配置される。すなわち、触媒CVD装置21のように基体24が真空容器の中央に設置される場合には、基体の外側に配置される熱触媒体25を取り囲むように配置される。この場合のガス吹き出し手段26は、内周面33に多数のガス吹き出し孔32を有する、中空構造の円筒状とする。ガス吹き出し孔32は、小さな円形や三角形、正方形、長方形、菱形、六角形、スリット状などの孔が、碁盤目状などの一定間隔や、ガス吹き出しのムラを考慮して分布を持たせた間隔で多数設けられ、基体24へ向けた均一なガス吹き出しを実現する。 40

【0032】ガス吹き出し手段26は、その外壁が容器22を兼ねる構成にすることで装置の小型化が図れ、それにより、装置を設置する空間の利用効率や装置の取扱性、装置製作の容易性、後述するように複数個の容器22を配列する場合の量産性などに優れた触媒CVD装置が提供される。このためには、外壁とガス吹き出し孔32を有する内周面33を一体に形成したガス吹き出し手段26としてもよいし、ガス吹き出し孔32の設けられた内周面33となる筒体を容器22の内面に嵌め合わせることによって、ガス吹き出し手段26を形成するよう50

にしてもよい。また、ガス吹き出し手段26の内部には、ガス分布の一層の均一化を図るために、内周面33 に設けたガス吹き出し孔32よりも疎な密度でガス通過 孔を開けた金属性の簡体を、パッファ板として設けると

8

よい。

【0033】このガス吹き出し手段26の内周面33 は、成膜中には、基体24と同様に熱触媒体25からの 輻射熱を受ける。しかし、ガス吹き出し手段26は成膜 用ガスが供給されることによりガスによる冷却作用を受 りること、また外壁が真空容器を兼ねていることで、輻 射熱を効果的に吸収、放散することができる。従って、 この熱触媒体25からの輻射熱を吸収、放散する作用に より、基体24へ向かう輻射熱の低減が図れ、基体温度 の安定化に寄与することができる。

【0034】このような、ガス吹き出し手段26により 輻射熱を吸収、放散する作用は、真空容器を兼ねている 外壁に、水冷ジャケットや空冷ジャケット等の冷却手段 を設けることで、その効果をより高めることができる。 そのような装置の例として、図5に概略構成図を、図6にその機断面図を示す。37が冷却手段としての水冷ジャケットであり、40は冷却水供給口、41は冷却水排出口である。この冷却水の温度や流量は、成膜条件に応じて、適宜設定される。

【0035】本発明の触媒CVD装置に用いられるa-Si系膜の原料ガスは、グロー放電プラズマCVD法で 用いられるものと同様である。すなわち、成膜原料ガス としては、シリコンと水素やハロゲン元素とからなる化 合物、例えばSiHa、Si2 Ha、Si3 Ha、Si F4、SiCl4、SiCl2 H2 等が用いられる。希 釈用ガスとしては、H2、N2、He、Ar、Ne、X e 等が用いられる。価電子制御ガスには、P型不純物と しては元素周期律表第III族Bの元素(B、A1、Ga 等) を含む化合物、例えばB2 H6 、B (CH8) 3 、 Al (CH₃)₃, Al (C₂ H₅)₃, Ga (C H:) 等が用いられ、N型不純物としては元素周期律 表第V族Bの元素(P、As、Sb等)を含む化合物、 例えばPHs 、P2 H4 、AsHs 、SbHs 等が用い られる。また、パンドギャップ調整用ガスとしては、パ ンドギャップを拡大する元素であるC、N、Oを含む化 40 合物、例えばCH4 、C2 H2 、C8 H8 、N2 、NH s、NO、N2 O、NO2、O2、CO、CO2 等や、 パンドギャップを狭める元素であるGe、Snを含む化 合物、例えばGeH4、SnH4、Sn (CHs) 3 等 が用いられる。

【0036】成膜に当たっては、これらのガスを減圧弁やマスフローコントローラーなどを用いて所望の流量や混合比に調整し、ガス導入管34より真空容器22に導入して、ガス吹き出し手段26から熱触媒体25を介して基体24表面に供給する。

【0037】成膜時のガス圧力は、0.001~20T

Q

orr、好適には0.005~10Torr、更に好適 には0.01~1Torrに設定される。ガス圧力をこ の範囲に設定することで、供給されたガスが効率的に分 解、輸送される。また反応生成物同士の気相中での2次 反応が抑制されることにより、基体上に良質なa-Si 系膜を形成することが出来る。なお、より高品質の膜を 得るためには、成膜を開始するに先立って、基体がセッ トされた後の真空容器22内を一旦10-6Torr程度 の高真空に排気し、容器内の水分や残留不純物ガスを除 去しておくことが望ましい。

【0038】以上の各構成の組合せにより、下配のよう な作用によって、電子写真感光ドラム等の円筒状基体へ の成膜に適した触媒CVD装置が提供できた。すなわ ち、基体支持体を筒状とすることで円筒状基体の保持が 可能となり、その支持体内部に温度検出手段と加熱手段 と冷却手段からなる基体温度制御手段を設けることで、 成膜中に熱触媒体からの輻射熱を受けても、ガスの利用 効率を低下させることなく基体温度が維持できた。ま た、基体支持体の回転機構も付加し、その位置精度も高 めたことで、基体上への均等な成膜が行なえるようにな 20 った。さらに、基体支持体の形状を多面体状とすること により、複数の平板状基体への成膜も行なえるようにな った。

【0039】また、熱触媒体の形状を基体支持体より大 きな径の筒状としてそれらの中心軸がほぼ同一となるよ うに配設してガスが透過する構造とし、加えて、その熱 触媒体を取り囲むようにガス吹き出し手段を設けて、基 体表面へ向けて均等に原料ガスを供給するようにしたこ とにより、成膜用堆積種を均等に供給でき、基体上への 一様な成膜が行なえるようになった。

【0040】また、ガス吹き出し手段の外壁を真空容器 を兼ねる構成にしたことで、装置の小型化が図れた。さ らに、ガス吹き出し手段に供給される原料ガスによる冷 却効果を利用することで、熱触媒体からの輻射熱によっ て基体が加熱される問題を軽減でき、成膜温度が安定し た。この効果は、ガス吹き出し手段の外壁に冷却ジャケ ットを設けることで、より高められる。

【0041】また、原料ガスとして例示した種々のガス を組み合わせて使用することで、a-Si系膜のパンド ギャップや導電型も制御でき、所望の電子写真特性を備 40 えた積層型感光体を作製することができた。

【0042】以下、具体的な実験例を述べる。この触媒 CVD装置21により、以下のようにして図21に示す 層構成のa-Si電子写真感光ドラムを作製した。図2 1において、42、43、44および45は、それぞれ 導電性の基体、キャリア注入阻止層、光導電層および表 面保護層を表わす。

【0043】図1および図2の構成の触媒CVD装置2 1において、熱触媒体25に0.5mm径の純度99.

状に巻いたものを用い、熱触媒体と基体との距離は30 mmとした。また、基体の加熱手段27にはカートリッ ジヒーターを、冷却手段28には窒素ガスを用いた。

10

【0044】この装置21に、表面を鏡面仕上げした直 径100mm、長さ360mmの円筒状A1基体をセッ トし、基体温度を250℃に加熱しながら、ロータリー ポンプと油拡散ポンプにより1×10% Torrの真 空度まで真空排気を行なった。次に熱触媒体を、通電し て1500℃に加熱し、真空ポンプをロータリーポンプ 10 とプースターポンプの組合せに切り換え、表1の条件で キャリア注入阻止層43、光導電層44、表面保護層4 5を順次形成し、a-Si電子写真感光ドラム(以下、 a-Siドラムと略す) Aを作製した。

[0045]

【表1】

Щ	ガスヴ	ガス流量 (sccm)	; m)	熱粒媒温度	ガス圧	中	膜厚
	S i H4	SiH4 B2 H8	CH₄	(2)	(Torr)	*	(m m)
表面保護層	7		200		1500 0.01	0 9	0.3
光導電層	125	**2		1500	1500 0.01 480	480	2.0
注入阻止層	5 0	50 *2.5		1500	1500 0.01	120	2
		*0B; H **0B;	Is ガスは、 He ガスは	*のB: H。ガスは、0.2%の濃度でH。希釈されている。 **のB: H。ガスは、20ppmの濃度でH。希釈されている。	腹でH: 希約1の濃度でH:	されている。希釈されてい	ွဲ့ ရ

99%のタングステンワイヤーで作られたメッシュを筒 50 【0046】このa-SiドラムAの帯電特性を、+6

11

k Vの電圧を印加したコロナ帯電器を用いて測定したところ、500Vの帯電電位を示した。また、光感度特性も500Vからの半減露光量が0.8 lux・sec と良好で、残留電位も5V以下と優れた特性を示した。

【0047】そして、このa-SiドラムAを市販の普通紙複写機に搭載して画像評価を行なったところ、画像 濃度が高く、バックのかぶりのない、解像力の優れた画像が得られた。また、画像中の黒点や白点等の画像欠陥は、グロー放電プラズマCVD法によるa-Siドラムよりも少なく、高い画像品質であった。

【0048】次に、触媒CVD装置21の基体支持体23を図3のように断面が8角形の形状のものとし、熱触媒体25には、0.5mm径の純度99.99%のタングステンワイヤーを、細い棒状のセラミックス製の支持体を骨組みとして、円筒状に巻いたものを用いた。

【0049】この装置に、幅15mm、長さ240mmの密着型イメージセンサ用の基体をセットして基体温度を250℃に加熱しながら、ロータリーポンプと油拡散ポンプにより1×10-6Torrの真空度まで真空排気を行なった。そして、熱触媒体を、通電して1500℃ 20に加熱し、真空ポンプをロータリーポンプとブースターポンプに切り換え、表2の条件でa-SiN層、i型a-Si層、p型a-Si層を順次形成し、a-Si密着型イメージセンサBを作製した。

【0050】 【表2】

12 娅 Ê က 0 2 0 孌 Ö $\widehat{\mathfrak{F}}$ 2 业 (Torr) ガス圧 0 0 希釈されている 0 0 0 0 0 0 0 3 S S S %の徹底でHi 0 ž 8 ö က 3 CE D 7,44 H Ø œ -ပ R 00 H Н° ガス流量 щ. . B2 **B**2 6 G -Ξ വ Ġ S 100 S z

30

【0051】この密着型イメージセンサBの明暗特性を 40 被長570nm、光量90 luxのLEDを用いて測定し たところ、明暗電流比Ip / Id が約1×10³ と優れ た特性を示した。

Т

m m

型型

1

S

1

10

【0052】〔例2〕図7に、本発明の簡求項2に係る 触媒CVD装置46の構成の横断面図を示す。基本的な 装置の構成は図1の装置21と同様であるが、この装置 46で用いる基体の形状は平板状であり、図7に示すよ うに、複数個の基体24を真空容器22の内壁側に設け られた基体支持体47上に、多面体もしくはほぼ円筒状 の形状となるように配置する。

50 【0053】この装置46においては、ガス吹き出し手

段48は、基体24に向けてガスを供給するように、熱 触媒体25の内側に中心軸がほぼ同一となるように配設 される。この場合のガス吹き出し手段48は、外周面に 多数のガス吹き出し孔32を有する、中空構造の円筒状 とする。ガス吹き出し孔32は、装置21と同様に、小 さな円形や三角形、正方形、長方形、菱形、六角形、ス リット状などの孔が、碁盤目等の一定間隔や、ガス吹き 出しのムラを考慮して分布を持たせた間隔で多数設けら れ、基体24へ向けた均一なガス吹き出しを実現する。 このガス吹き出し手段48の内部にも装置21と同様 に、ガス分布の一層の均一化を図るためにいくつかのパ ッファ板を設けるとよい。また、装置46ではガス吹き 出し手段が真空容器の外壁を兼ねなくてもよいため、ガ ス吹き出し手段48として図7に示したような1個の筒 体の他に、側面に複数のガス吹き出し孔を有する複数の ガス導入管を設置して、熱触媒体25を介して基体24 へ向けてガス吹き出しを行なってもよい。

【0054】このガス吹き出し手段48の外周面は、成膜中には、基体24と同様に熱触媒体25からの輻射熱を受ける。しかし、ガス吹き出し手段48は成膜用ガスのが供給されることによりガスによる冷却作用を受けることで、輻射熱を効果的に吸収、放散することができる。従って、この熱触媒体25からの輻射熱を吸収、放散する作用により、基体24へ向かう輻射熱の低減が図れ、基体温度の安定化に寄与することができる。

【0055】このような、ガス吹き出し手段48により輻射熱を吸収、放散する作用は、ガス吹き出し手段48の内部に、水冷や空冷等による冷却手段を設けることで、その効果をより高めることができる。このような冷却手段を設けたガス吹き出し手段48を用いた例として、図8にその装置46の横断面図を示す。同図において、49が冷却手段であり、ガス吹き出し手段48の外周面に接して設けられた中空構造の冷却手段49の内部に、冷却水や冷却気体を循環させて、ガス吹き出し手段48の外周面を所望の温度に設定することにより、熱触媒体25からの輻射熱を吸収、放散する。また、真空容器22の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、熱触媒体から基体への輻射熱の一部を吸収、放散する作用を高めることができ、輻射熱の影響をより一層軽減できる。

【0056】以上の構成の触媒CVD装置46によれば、下記のような作用によって、複数個の平板状基体への成膜に適した触媒CVD装置が提供できた。すなわち、基体支持体を真空容器の内壁側に設けた筒状とすることで複数個の平板状基体の保持が可能となり、その支持体内部に温度検出手段と加熱手段と冷却手段からなる基体温度制御手段を設けることで、成膜中に熱触媒体からの輻射熱を受けても、ガスの利用効率を低下させることなく基体温度が維持できた。

【0057】また、熱触媒体を基体支持体の内側に配置 50

14

した同軸状の筒型とし、加えて、その熱触媒体の内側に ガス吹き出し手段を設けて、基体表面へ向けて均等に原 料ガスを供給するようにしたことにより、成膜用堆積種 を均等に供給でき、複数個の平板状基体上への一様な成 膜が行なえるようになった。

【0058】また、基体を真空容器の内壁全体にわたって配置したことで、装置の小型化が図れた。そして、ガス吹き出し手段に供給される原料ガスによる冷却効果を利用することで、熱触媒体からの輻射熱によって基体が加熱される問題を軽減でき、成膜温度が安定した。この効果は、ガス吹き出し手段の内部に冷却手段を追加することで、より高められる。また、真空容器の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、輻射熱の影響をより一層軽減できる。

【0059】 更に、原料ガスとして例示した種々のガスを組み合わせて使用することで、a-Si系膜のバンドギャップや導電型も制御できる。

【0060】以下、具体的な実験例を述べる。触媒CV D装置46の基体支持体を、図7に示したように20面体の形状とし、熱触媒体25には、0.5mm厚の純度99.99%のタングステン平板に0.5mmの穴を10mmピッチの碁盤目状に開けたものを、円筒状に巻いたものを用いた。

【0061】この装置 46に、幅15mm、長さ240mmの密着型イメージセンサ用の基体をセットして、〔例1〕と同様に基体温度を250℃に加熱しながら、ロータリーポンプと油拡散ポンプにより 1×10^{-6} Torの真空度まで真空排気を行なった。

【0062】次に熱触媒体を、通電して1500℃に加 の 熱し、真空ポンプをロータリーポンプとプースターポン プに切り換え、表3の条件でa-SiN層、i型a-S i層、p型a-Si層を順次形成し、a-Si密着型イ メージセンサCを作製した。

[0063]

【表3】

III.		ガス流量(s	(sccm)		魚触媒温度	ガス圧	整	類	
	S i H	В2 Нв	H	N2	(2)	(Torr)	*	(m m)	
p型a-Si層	5. 7		6 . 9	6.0	1500	0.01	3.0	0. 1	1
i型a-Si層	17.7		21.6		1500	0.01	0 6	1. 0	Τ
a-SiN層	20.1	20. 1 11. 4 24. 0	24.0		1500	0.01	2 0	0. 2	т—
		B2 H8 ガスは、		0. 2%の機度でH:	までH, 希釈さ	希釈されている。			7

【0064】この密着型イメージセンサCの波長570 nm、光量90 luxのLEDを用いて測定したところ、 明暗電流比 Ip / Id が約1×103 と優れた特性を示 した。

【0065】〔例3〕図9に、本発明の請求項1または 請求項2に係る触媒CVD装置を複数個連結した触媒C VD装置50の構成の概略図を、また図10にその横断 面図を示す。この装置50は、装置21または装置46 の真空容器22を複数個配置して、ガス供給配管系およ びガス排気配管系を共通化したものであり、図9および 図10では、4個の真空容器22を円周状に配置し、後

設けた例を示す。

【0066】これらの装置で用いる基体の形状は、装置 21や装置46と同様に円筒状もしくは平板状のものを

16

【0067】この装置50のように、複数個の真空容器 22を並列もしくは円周上に配列して同時に成膜を行な うことで、各真空容器22へのガス供給配管系と排気配 管系を共通化することを特徴とする、量産に適した触媒 CVD装置が提供される。

10 【0068】複数個の真空容器のガス供給配管系を共通 化する場合には、各原料ガスをマスフローコントローラ 一等により所望の流量に設定して混合し、その混合ガス の供給配管系にガス分岐配管を設けて、各容器22に向 けて分岐して接続する。この分岐配管の管径や各容器2 2への長さが均等になるように設定することで、均等な ガス分配が可能になる。さらに、分岐の部分に、ガス供 給配管より大きくかつ真空容器より小さい内径を有する ガス供給集合器51を設けることで、より均等なガス分 配が可能になる。

20 【0069】また、複数個の容器22のガス排気配管系 を共通化する場合には、各容器22からの排気配管35 を集合させ、1本の配管にして真空ポンプに接続する。 この場合も、配管35の管径や各容器22からの配管の 長さが均等になるように設定することで、均等なガス排 気が可能になる。さらに、配管の集合部分に、排気配管 より大きく真空容器より小さい内径を有するガス排気集 合器52を設けることで、より均等なガス排気が可能に なる。

【0070】以上の構成の触媒CVD装置50によれ 30 ば、触媒CVD装置21や触媒CVD装置46の作用効 果に加えて、下記のような作用によって、電子写真感光 ドラム等の複数個の円筒状基体あるいは平板状基体への 成膜に適した、量産性に優れた触媒CVD装置が提供で きた。

【0071】すなわち、複数個の真空容器を並列もしく は円周上に配列して、それらのガス供給配管系と排気配 管系を共通化することにより、装置全体の小型化を図り つつ、多数の基体に同時に均等な成膜が行なえる、量産 性に優れた装置となった。そして、ガス供給配管系およ 40 び排気配管系に、それぞれガス供給集合器およびガス排 気集合器を付設することで、より均等な成膜が行なえ る。

【0072】以下、具体的な実験例を述べる。この触媒 CVD装置50のそれぞれの真空容器22を、装置21 と同様の構成とし、熱触媒体25に、0.5mm径の純 度99.99%のタングステンワイヤーで作られたメッ シュを円筒状に巻いたものを用いた。各容器22に、表 面を鏡面仕上げした直径100mm、長さ360mmの 円筒状A 1 基体をセットし、基体温度を250℃に加熱 述するガス供給集合器51およびガス排気集合器52を 50 しながら、ロータリーポンプと油拡散ポンプにより1×

10-6 Torrの真空度まで真空排気を行なった。

【0073】次に、各真空容器の熱触媒体を、通電して 1500℃に加熱し、真空ポンプをロータリーポンプと プースターポンプに切り換え、表4の条件でキャリア注 入阻止層43、光導電層44、表面保護層45を形成 し、a-SiドラムD1~D4を作製した。

[0074]

【表4】

ii.	HZÌ	ガス流暦 (sccm)) ш	熱烛媒溫度	ガス圧	1 全	膜厚
	S i H.	SiHe Br He	CH,	(2)	(Torr)	€	(m m)
表面保護層	2 8		800	800 1500	0.01	7.0	0.3
光導電層	200	200 **8		1500	1500 0.01	500	2 0
注入阻止層	200	200 *10		1500	1500 0.01 140	140	2
		*0B; H **0B;	I, #744, He #746	*のB: H。ガスは、0.2%の濃度でH: 希釈されている。 **のB: H。ガスは、20ppmの濃度でH: 希釈されている。	腹でH,希別の濃度でH,	だれている。 希釈されてい	ئځ،

【0075】このa-SiドラムD1~D4の帯電特性 を、+6kVの電圧を印加したコロナ帯電器を用いて測 定したところ、いずれも500Vの帯電電位を示した。 また、光感度特性も500Vからの半減露光量が0.8 lux・sec と良好で、残留電位も5 V以下と優れた特性 を示した。

【0076】 そして、このa-SiドラムD1~D4を

18

ろ、いずれも画像濃度が高く、パックのかぶりのない、 解像力の優れた画像が得られた。また、画像中の黒点や 白点等の画像欠陥は、グロー放電プラズマCVD法によ るa-Siドラムよりも少なく、高い画像品質であっ た。

【0077】これにより、本構成の触媒CVD装置50 は、一度の成膜工程で複数のa-SIドラムの製作が可 能な、量産性に優れた触媒CVD装置であることが確認 された。

10 【0078】 [例4] 図11に、本発明の請求項3に係 る触媒CVD装置53の構成の概略図を、また図12に その横断面図を示す。この装置53は、円周上に配置し た複数個の円筒状の基体に同時に成膜を行なうものであ る。また、基体支持体23の形状を図3に示したものと 同様にすると、複数個の平板状の基体にも同時に成膜を 行なうことができる。

【0079】この装置53では、基体24が真空容器5 4の内壁と熱触媒体との間に設置されるので、ガス吹き 出し手段48は、複数個の基体24に向けてガスを供給 20 するように、熱触媒体25の内側に配置される。このガ ス吹き出し手段48も、外周面に多数のガス吹き出し孔 32を有する、中空構造の筒状とする。ガス吹き出し孔 32は、小さな円形や三角形、正方形、長方形、菱形、 六角形、スリット状などの孔が、碁盤目等の一定間隔 や、ガス吹き出しのムラを考慮して分布を持たせた間隔 で多数設けられ、複数個の基体24へ向けての均一なガ ス吹き出しを実現する。ここでも、ガス分布の一層の均 一化を図るために、内部にいくつかのパッファ板を設け るとよい。また、装置53でもガス吹き出し手段48が 30 容器 5 4 の外壁を兼ねなくてもよいため、ガス吹き出し 手段48として図11および図12に示したような1個 の簡体の他に、側面に複数のガス吹き出し孔を有する複 数のガス導入管により、熱触媒体25を介して複数個の 基体24へ向けてガス吹き出しを行なってもよい。

【0080】このガス吹き出し手段48の外周面は、成 膜中には、基体24と同様に熟触媒体25からの輻射熱 を受ける。しかし、ガス吹き出し手段48は成膜用ガス が供給されることによりガスによる冷却作用を受けるこ とで、輻射熱を効果的に吸収、放散することができる。 40 従って、この熱触媒体25からの輻射熱を吸収、放散す る作用により、基体24へ向かう輻射熱の低減が図れ、 基体温度の安定化に寄与することができる。

【0081】このような、ガス吹き出し手段48により 輻射熱を吸収、放散する作用は、ガス吹き出し手段48 の内部に、水冷や空冷等による冷却手段を設けること で、その効果をより高めることができる。このような冷 却手段を設けたガス吹き出し手段48を用いた例とし て、図13にその概略構成図を、図14にその横断面図 を示す。図13および図14において、49が冷却手段 市販の普通紙複写機に搭載して画像評価を行なったとこ 50 であり、ガス吹き出し手段48の外周面に接して設けら

g - ***. * * *

19

れた中空構造の冷却手段49の内部に、冷却水や冷却気体を循環させて、ガス吹き出し手段48の外周面を所望の温度に設定することにより、熱触媒体25からの輻射熱を吸収、放散する。また、真空容器54の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、熱触媒体から基体への輻射熱の一部を吸収、放散する作用を高めることができ、輻射熱の影響をより一層軽減できる。

【0082】以上の構成の触媒CVD装置53によれば、下記のような作用によって、電子写真感光ドラム等の複数個の円筒状基体あるいは複数個の平板状基体への 10 成膜に適した、量産性に優れた触媒CVD装置が提供できた。

【0083】すなわち、筒状とした複数の基体支持体を真空容器内に円周上に配列することで複数個の円筒状基体の保持が可能となり、その支持体内部に温度検出手段と加熱手段と冷却手段からなる基体温度制御手段を設けることで、成膜中に熱触媒体からの輻射熱を受けても、ガスの利用効率を低下させることなく基体温度が維持できた。また、基体支持体の回転機構も付加し、その位置精度も高めたことで、複数個の基体上へ同時に均等な成20膜が行なえるようになった。さらに、それぞれの基体支持体を多面体状とすることにより、多数の平板状基体への同時成膜も行なえるようになった。これにより、1台の装置での1回の成膜工程で、多数の基体へ成膜が行なえる、最産性に優れた触媒CVD装置が提供できた。

【0084】また、熱触媒体の形状を容器中央のガス吹き出し手段を一様に取り囲むようにし、加えて、その熱触媒体と中心軸がほぼ同一となるように複数の基体支持体を同心円上に配列して、基体表面へ向けて均等に原料ガスを供給するようにしたことにより、成膜用堆積種を30均等に供給でき、複数個の基体上への一様な成膜が行なえるようになった。

【0085】また、真空容器の中に多数の基体を配置する構成にしたことで、装置の小型化が図れた。さらに、ガス吹き出し手段に供給される原料ガスによる冷却効果を利用することで、熱触媒体からの輻射熱によって基体が加熱される問題を軽減でき、成膜温度が安定した。この効果は、ガス吹き出し手段の内部に冷却手段を追加することで、より高められる。また、真空容器の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、輻射熱の影響をよ 40 り一層軽減できる。

【0086】以下、具体的な実験例を述べる。図11および図12に示したように、触媒CVD装置53の真空容器54内部に、16本の基体支持体23を円周上に配置し、熱触媒体25には、0.5mm径の純度99.99%のタングステンワイヤーで作られたメッシュを円筒状に巻いたものを用いた。

【0087】この装置53の各支持体23に、表面を鏡 た。また、光感 面仕上げした直径30mm、長さ260mmの円筒状A 0.8 lux・sec 1基体24をセットし、基体温度を250℃に加熱しな 50 た特性を示した。 20 と油坩サポンプに F n

がら、ロータリーポンプと油拡散ポンプにより1×10 -6 Torrの真空度まで真空排気を行なった。

【0088】次に、複数の基体支持体の列の内側に配置された熱触媒体を、通電して1500℃に加熱し、真空ポンプをロータリーポンプとプースターポンプに切り換え、表5の条件でキャリア注入阻止層43、光導電層44、表面保護層45を形成し、a-SiドラムE1~E16を作製した。

[0089]

【表5】

	ガスヴ	ガス流量 (sccm)	: m)	熱触媒温度	ガス圧	自由	腹厚
	S i H4	SiH4 B2 H6	'H'O	(, 2)	(Torr)	(₹)	(m m)
表面保護層	3 5	-	0001	1500	0.01 100	100	0.3
光導電層	625	6 * *		1500	0.01	8 0 0	2 0
注入阻止層	250	*12		1500	0.01 180	180	2
		*0B; F **0B;	f。ガスは、 H。ガスは	*のB: H。ガスは、0.2%の濃度でH: 希釈されている。 **のB: H。ガスは、20ppmの濃度でH: 希釈されている。	度でH:希別の遺産でH:	されている。希釈されてい	78,

【0090】このa-Siドラム $E1\sim E16$ の帯電特性を、+6k Vの電圧を印加したコロナ帯電器を用いて測定したところ、いずれも500 Vの帯電電位を示した。また、光感度特性も500 Vからの半減露光量が0.8ix・sec と良好で、残留電位も5 V以下と優れた特性を示した。

[0091] そして、このa-SiドラムE1~E16 を市販の普通紙複写機に搭載して画像評価を行なったと ころ、いずれも画像濃度が高く、パックのかぶりのな い、解像力の優れた画像が得られた。また、画像中の黒 点や白点等の画像欠陥は、グロー放電プラズマCVD法 によるa-Siドラムよりも少なく、高い画像品質であ った。

【0092】これにより、本構成の触媒CVD装置53 は、1度の成膜工程で多数のa-Siドラムの製作が可 能な、量産性に優れた触媒CVD装置であることが確認 10 された。

【0093】〔例5〕図15に、本発明の請求項4に係 る触媒CVD装置55の構成の概略図を、また図16に その横断面図を示す。この装置55は、直線状に配列し た複数個の円筒状の基体に同時に成膜を行なうものであ る。また、基体支持体57の形状を図3に示したものと 同様にすると、複数個の平板状の基体にも同時に成膜を 行なうことができる。

【0094】この装置55の真空容器56には、基体2 4のセットや取り出しが一体的に行なえるように、直線 状に配列した複数個の基体24と直交する側の容器56 の側壁に、いくつかのゲートパルプ58が設けられる。 そして、このゲートパルプ58を介して複数の真空容器 56を連結させることにより、成膜室の前後に真空排気 や予備加熱を行なったり、冷却や真空リークを行なった りする予備室を設けたり、各層毎の成膜室を分離するこ とによって各層の膜質の向上を図る、いわゆるインライ ン型の量産性に優れた触媒CVD装置とすることも可能 となった。

【0095】この装置55においては、複数個の基体支 30 持体57が一体となって真空容器56中を移動できるよ うな構造とするために、複数個の支持体57が車輪59 を備えた台車60に一体的に設置され、基体温度制御手 段61や回転伝達手段62は、真空中で接続や切り離し が可能なように構成される。このような接続機構として は、電気的な配線については電流接続端子とソレノイド の組合せやスリップリングとプラシの組合せ等が用いら れ、媒体についてはクイックカップリングとソレノイド の組合せ等が用いられる。また、回転や搬送の動力の伝 達については、ギヤ同士の組合せやギヤとソレノイドの 40 組合せ等が用いられる。

【0096】この装置55のように複数個の基体24が 直線状に配列される場合には、ガス吹き出し手段63は 平面形状とし、熱触媒体64を介して基体24とは反対 側に配置する。このガス吹き出し手段63は、基体24 と対向する外面にガス吹き出し孔32を有する、中空平 板状とする。このガス吹き出し孔32も、碁盤目等の一 定間隔や、ガス吹き出しのムラを考慮して分布を持たせ た間隔で多数設けられ、基体24へ向けての均一なガス 吹き出しを実現する。ここでも、ガス分布の一層の均一 50 ガスの利用効率を低下させることなく基体温度が維持で

化を図るために、内部にいくつかのパッファ板を設ける とよい。また、装置55でもガス吹き出し手段63が容 器56の外壁を兼ねなくてもよいため、ガス吹き出し手 段63として図15および図16に示したような1個の 中空平板の他に、側面に複数のガス吹き出し孔を有する 複数のガス導入管により、熱触媒体64を介して複数個 の基体24へ向けてガス吹き出しを行なってもよい。

【0097】このガス吹き出し手段63の外面は、成膜 中には、基体24と同様に熱触媒体64からの輻射熱を 受ける。しかし、ガス吹き出し手段63は成膜用ガスが 供給されることによりガスによる冷却作用を受けること で、輻射熱を効果的に吸収、放散することができる。従 って、この熱触媒体64からの輻射熱を吸収、放散する 作用により、基体24へ向かう輻射熱の低減が図れ、基 体温度の安定化に寄与することができる。

【0098】このような、ガス吹き出し手段63により 輻射熱を吸収、放散する作用は、ガス吹き出し手段63 の内部に、水冷や空冷等による冷却手段を設けること で、その効果をより高めることができる。また、真空容 器の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、熱触 媒体から基体への輻射熱の一部を吸収、放散する作用を 高めることができ、輻射熱の影響をより一層軽減でき る。このような冷却手段を設けたガス吹き出し手段63 を用いた例として、図17にその概略構成図を、図18 にその横断面図を示す。図17および図18において、 65が冷却手段であり、ガス吹き出し手段63の外周面 に接して設けられた中空構造の冷却手段65の内部に、 冷却水や冷却気体を循環させて、ガス吹き出し手段63 の外周面を所望の温度に設定することにより、熱触媒体 64からの輻射熱を吸収、放散する。また、真空容器5 6の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、熱触 媒体から基体への輻射熱の一部を吸収、放散する作用を 高めることができ、輻射熱の影響をより一層軽減でき

【0099】なお、上記の例では直線状に配列した複数 個の基体支持体をガス吹き出し手段の両側に並設した場 合を示したが、片側のみに並散しても同様に良好な成膜 結果が得られ、量産性に優れた触媒CVD装置となるこ とは、貫うまでもない。

【0100】以上の構成の触媒CVD装置55によれ ば、下記のような作用によって、電子写真感光ドラム等 の複数個の円筒状基体あるいは複数個の平板状基体への 成膜を繰り返し行なうことのできる、量産性に優れた触 媒CVD装置が提供できた。

【0101】すなわち、筒状とした複数の基体支持体を 真空容器内に直線状に配列することで複数個の円筒状基 体の保持が可能となり、その支持体内部に温度検出手段 と加熱手段と冷却手段からなる基体温度制御手段を設け ることで、成膜中に熱触媒体からの輻射熱を受けても、

きた。また、基体支持体の回転機構も付加し、その位置 精度も高めたことで、複数個の基体上へ同時に均等な成 膜が行なえるようになった。さらに、それぞれの基体支 持体を多面体状とすることにより、多数の平板状基体へ の同時成膜も行なえるようになった。直線状に配列され た基体が一体となって真空容器中を移動できる構成とし たので、いわゆるインライン型の成膜装置に適用でき、 これにより、1台の装置での1回の成膜工程で、多数の 基体へ成膜が行なえて、かつ繰り返して成膜を行なえ る、量産性に優れた触媒CVD装置が提供できた。

【0102】また、熱触媒体の形状を容器中央のガス吹き出し手段を一様に優うようにし、加えて、その熱触媒体を介して基体支持体を直線状に配列して、基体表面へ向けて均等に原料ガスを供給するようにしたことにより、成膜用堆積種を均等に供給でき、複数個の基体上への一様な成膜が行なえるようになった。

【0103】また、真空容器の中に多数の基体を配置する構成にしたことで、装置の小型化が図れた。さらに、ガス吹き出し手段に供給される原料ガスによる冷却効果を利用することで、熱触媒体からの輻射熱によって基体 20 が加熱される問題を軽減でき、成膜温度が安定した。この効果は、ガス吹き出し手段の内部に冷却手段を追加することで、より高められる。また、真空容器の外壁にさらに冷却手段を追加することにより、輻射熱の影響をより一層軽減できる。

【0104】以下、具体的な実験例を述べる。図15および図16に示したように、触媒CVD装置55に円筒 状基体を直線状に5本ずつ配列し、熱触媒体64には、 0.5mm厚の純度99.99%のタングステン平板に

0. 5 mm径の穴を10 mmピッチの碁盤目状に開けた *30* ものを用いた。

【0105】この装置55に、表面を鏡面仕上げした直径80mm、長さ360mmの円筒状A1基体を、台車60上に直線状に5本配列した基体支持体57にセットし、容器56側面に設けたゲートバルブ58を通して、ガス吹き出し手段63の両側に2列に配置した。そして、基体温度を250℃に加熱しながら、ロータリーポンプと油拡散ポンプにより1×10-6Torrの真空度まで真空排気を行なった。

[0107]

【表6】

	ガスむ	ガス流量 (sccm)	m)	熱触媒温度	ガス圧	時間	顾
	SiH ₄ B ₂ H ₈	B, H,	сни	(<u>Q</u>	(Torr)	(*)	(m m)
表面保護層	2 8		008	1500	0.01	7.0	0.3
光導電層	500	8 * *		1500	0.01 600	009	2.0
注入阻止層	200	200 *10		1500	1500 0.01 140	140	2
		*0B; E **0B;	fe ガスは、 He ガスは	*のB: H: ガスは、0.2%の濃度でH: 希釈されている。 **のB: H: ガスは、20ppmの濃度でH: 希釈されている。	度でH。希別の意度でH。	されている。希釈されてい	5.

24

【0108】このa-SiドラムF1~F10の帯電特性を、+6kVの電圧を印加したコロナ帯電器を用いて測定したところ、いずれも500Vの帯電電位を示した。また、光感度特性も500Vからの半減露光量が0.8 lux・sec と良好で、残留電位も5V以下と優れた特性を示した

【0109】そして、このa-SiドラムF1~F10を市販の普通紙複写機に搭載して画像評価を行なったところ、いずれも画像濃度が高く、パックのかぶりのない、解像力の優れた画像が得られた。また、画像中の黒点や白点等の画像欠陥は、グロー放電プラズマCVD法によるa-Siドラムよりも少なく、高い画像品質であった。

【0110】これにより、本構成の触媒CVD装置55 は、一度の成膜工程で多数のa-Siドラムの製作が可 50 能な、量産性に優れた触媒CVD装置であることが確認

された。

【0111】〔例6〕 (比較例)

図20に示したグロー放電プラズマCVD装置1の基体 支持体3に、表面を鏡面仕上げした直径100mm、長 さ360mmの円筒状A1基体4をセットし、ロータリ ーポンプとブースターポンプからなる真空ポンプで排気 しながら、表7の条件でキャリア注入阻止層43、光導 電層44、表面保護層45を形成し、〔例1〕と同様の 図21に示す層構成のa-SiドラムGを作製した。

ا دا ا

[0112]

【表7】

Ų	Α.	ガス流量 (sccm)	ccm)		RF電力	ガス圧力	基板温度	首 鎖
	SiH, B, He	B ₂ H ₈	CH4	ON	(W)	(Torr)	(2)	(mm)
表面保護層	L		280		150	0.40	270	0.
光導電層	150	**2			150	0.40 270	270	2 0
注入阻止層	09	* 3		ħ	08	0.40	270	2
		*0B2 F	*0B2 He #744, 0 **0B8 H. #74		の機度でH2名	. 2%の濃度でH. 希釈されている。 2 O p n m の適能でH。 発射されている	50.2	

26

1) と同様に+6kVの電圧を印加したコロナ帯電器を用いて測定したところ、帯電電位は400Vであった。また、残留電位は5V以下と良好であったが、光感度特性は500Vからの半減露光量が0.9lux・secで、本発明によるa-SiドラムAおよびD~Fに比べて、特性がやや劣る結果であった。

【0114】そして、このa-SiドラムGを市販の普通紙複写機に搭載して画像評価を行なったところ、パックのかぶりはなく、解像力も良好な画像であったが、画10 像濃度がやや低かった。また、グロー放電分解による成膜中に発生する粉体の影響で、本発明によるa-SiドラムAおよびD~Fに比べて、画像中の黒点や白点等の画像欠陥が多く、やや劣る画像品質であった。

[0115]

【発明の効果】以上説明したように、本発明により、円筒状基体に良好な膜質のa-Si系膜を形成できる、電子写真感光体用の触媒CVD装置が提供できた。基体と熱触媒体とガス吹き出し手段の配置を本発明の構成にすることにより、ガス利用効率を低下させることなく、基20体への均等な成膜が行なえる。また、基体支持体に設けた基体温度制御手段やガス吹き出し手段の輻射熱吸収作用によっても、成膜時の基体温度が安定し、良質なa-Si系膜を形成できる。そして、これらの触媒CVD装置によれば、基体支持体の形状を変更することで、複数個の平板状基体への成膜が可能である。

【0116】また本発明により、一度の成膜工程で複数 個の平板状基体または円筒状基体に成膜できる、量産性 に優れた電子写真感光体用の触媒CVD装置が提供でき た。この装置によっても、基体支持体の形状を変更する 30 ことによって、複数個の平板状基体への成膜が可能であ る。

【0117】さらに本発明により、複数の真空容器や成膜室を連結して、一度の成膜工程で複数個の基体へ成膜でき、加えて、複数個の基体を間欠的に成膜室へ送り込んで、連続的に繰り返して成膜を行なうことができる、量産性に優れた電子写真感光体用の触媒CVD装置も提供できた。この装置によっても、基体支持体の形状を変更することによって、複数個の平板状基体への成膜が可能である。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の請求項1に係る触媒CVD装置の概略 構成図である。

【図2】本発明の請求項1に係る触媒CVD装置の横断 面図である。

【図3】本発明の請求項1に係る触媒CVD装置の横断面図である。

【図4】本発明の触媒CVD装置の熱触媒体の形状の例を示す図である。

【図5】本発明の請求項1に係る触媒CVD装置の他の

【0113】このa-SiドラムGの帯電特性を、〔例 50 構成の概略図である。

【図6】本発明の請求項1に係る触媒CVD装置の他の 構成の横断面図である。

【図7】本発明の請求項2に係る触媒CVD装置の横断 面図である。

【図8】本発明の請求項2に係る触媒CVD装置の他の 構成の横断面図である。

【図9】本発明の請求項1または請求項2に係る触媒C VD装置を複数個連結した触媒CVD装置の概略構成図 である。

【図10】本発明の請求項1または請求項2に係る触媒 10 CVD装置を複数個連結した触媒CVD装置の横断面図 である。

【図11】本発明の請求項3に係る触媒CVD装置の概略構成図である。

【図12】本発明の請求項3に係る触媒CVD装置の機 断面図である。

【図13】本発明の請求項3に係る触媒CVD装置の他の構成の概略構成図である。

【図14】本発明の請求項3に係る触媒CVD装置の他の構成の横断面図である。

【図15】本発明の請求項4に係る触媒CVD装置の概略構成図である。

【図16】本発明の請求項4に係る触媒CVD装置の横 断面図である。

【図17】本発明の請求項4に係る触媒CVD装置の他の構成の概略構成図である。

【図18】本発明の請求項4に係る触媒CVD装置の他の構成の横断面図である。

【図19】従来の触媒CVD装置の概略構成図である。

【図20】グロー放電プラズマCVD装置の概略構成図である。

【図21】a-Si電子写真感光ドラムの層構成を示す 断面図である。

【符号の説明】

2、14、22、54、56・・真空容器

3、23、47、57・・・・基体支持体

4、16、24・・・・・・基体

17、25、64・・・・・ 熱触媒体

18、26、48、63・・・ガス吹き出し手段

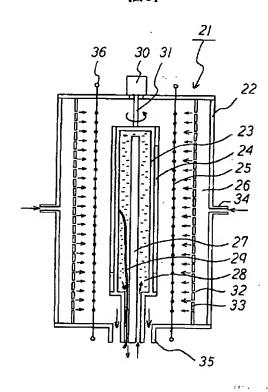
10、20、27・・・・・ 加熱手段

28・・・・・・・・・・冷却手段

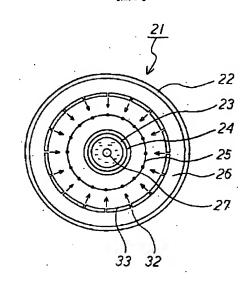
29・・・・・・・・・・ 温度検出手段

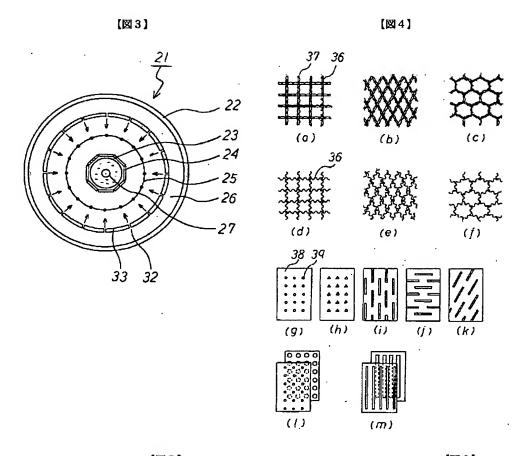
12、31、62・・・・・・回転伝達手段

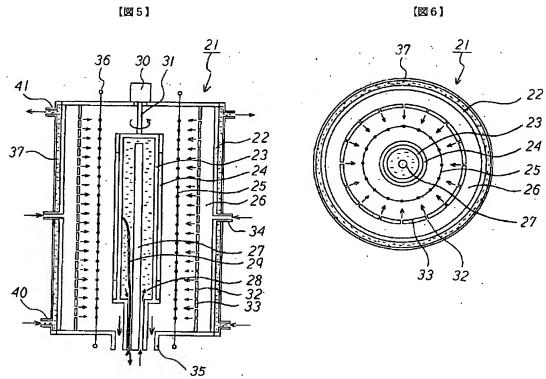
[図1]



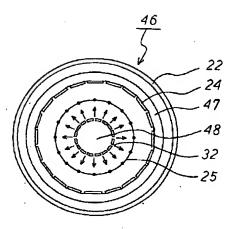
【図2】



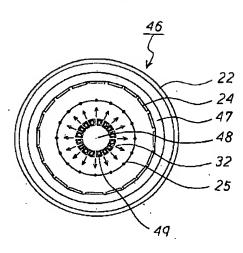




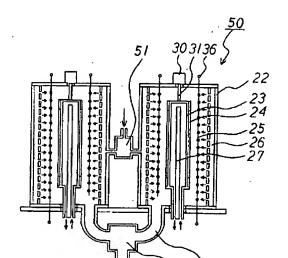
【図7】



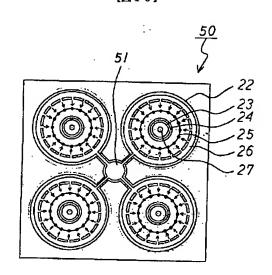
【図8】



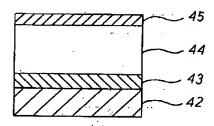




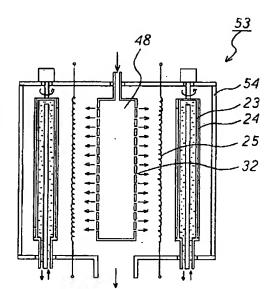
【図10】



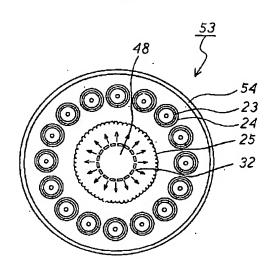
[図21]



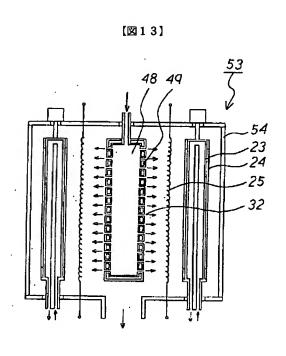
[図11]

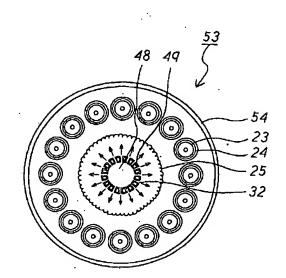


【図12】

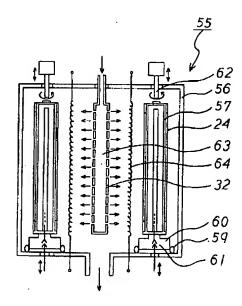


【図14】

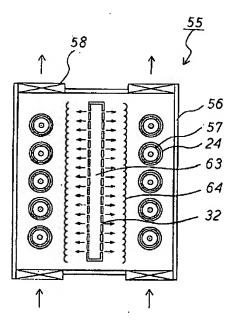




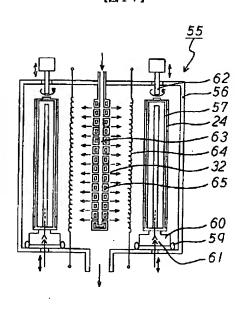
【図15】



【図16】



【図17】



0

-56

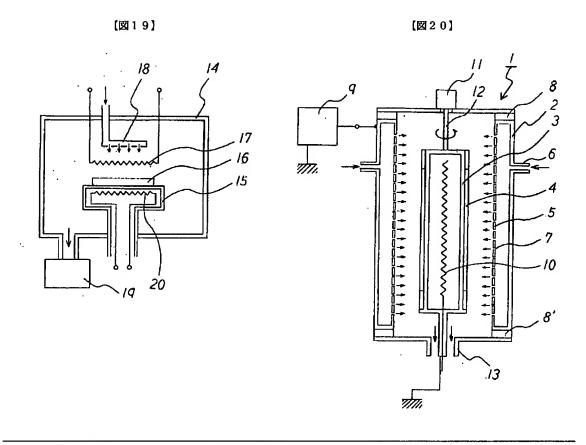
57

63

64

- 32 - 65

【図18】



フロントページの続き

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 阳

昭61-252914

(3) Int . Cl . 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)11月10日

F 16 C 13/00 // H 04 N 1/08 8613-3J 8220-5C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

図発明の名称 用紙巻付用ドラムおよびその製造方法

②特 願 昭60-91170

郊出 願 昭60(1985)4月30日

砂発明者 渡辺

茂 前橋市古市町180番地 東芝機器株式会社内

⑪出 願 人 東芝機器株式会社

前橋市古市町180番地

⑩代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

明細書

1. 発明の名称

用紙巻付用ドラムおよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(2)ドラム本体の内周面をこのドラム本体の 外周面を基準として両側面からそれぞれ所定幅に わたって切削すると共に、中心にてセンターシャ フトを保持するセンターシャフト保持部材の外周 面を前記センターシャフトを基準として切削し、 このセンターシャフト保持部材を前記ドラム本体の内周面に設けられた切削部に嵌合させて一体化した後、この一体化されたドラム本体とセンターシャフト保持部材との軸方向に用紙固定用スリットを形成するようにしたことを特徴とする用紙巻付用ドラムの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明はファクシミリ装置、複写機等に用いられる用紙巻付用ドラムおよびその製造方法に関する。

(発明の技術的背景およびその問題点)

 し、ドラム本体の外周面に記録紙あるいは送信原 画を巻付けたのちセンターシャフトによって回転 させるものとなっている。

ところで、このドラム回転時においては、偏心 等によってプレが生じてはならない。したがの高精 度なものが要求される。このため、従来、用紙巻 付用ドラムを製造する場合には、ドラム本体とセ ンターシャフト取付け部とをアルミニウムやプラ スチックを用いて押出し成形等の手法により一体 的に形成した後、センターシャフト取付け部と ンターシャフトを固着するものとなっていた。

しかるに、押出し成形等によって一体的に形成する場合には、高価な鋳型が必要となる上、工程が複雑となり、製造コストが高かった。また、ドラム外周部とセンターシャフトとの寸法精度は十分とは言えず、ドラム回転時に偏心等によってプレが生じるおそれがあった。

(発明の目的)

本発明の目的は、ドラム外周面とセンタシャフ

る。

また、本発明は、ドラム本体の内周面をこのドぞれの外径部を基準として両側面からにもたって切削すると共に、中でいたの内のでは、中でいたのでは、中では、マックの外のでは、マックを基準である。とは、アットを形成の内周では、このでは、アットを形成する。とは、アットを形成する。とは、アットを形成する。

(発明の実施例)

第1図および第2図は本発明の一実施例における用紙巻付用ドラムを示す部分断面図および側面図である。第1図および第2図において、1はプラスチックあるいはアルミニウムを原料にして成形等の手法によって造られたドラム本体であり、このドラム本体1の内周面両側には所定幅にわたって切削部2が形成される。3は前記切削部2に

トとの寸法精度が高く、回転時に偏心等によるプレが生じるおそれがない上、低コストで製造可能 な用紙巻付用ドラムを提供することにある。

また、本発明のもう一つの目的は、ドラム外周面とセンターシャフトとの寸法精度の向上をはかり得、回転時に偏心等によるプレが生じるおそれがない上、工程が簡単で製造コストを低減できる用紙巻付用ドラムの製造方法を提供することにある。

〔発明の概要〕

嵌合されるセンターシャフト保持部材であり、前 記ドラム本体1と同様にプラスチックあるいはア ルミニウムを原料として成形等の手法により造ら れている。このセンターシャフト保持部材3は、 前記ドラム本体1の内周面に切削により形成され た段差部4に当接するまで嵌挿され、接着材等に よってドラム本体1と一体となるように固定され るものとなっている。また、上記センターシャフ ト保持部材3の中心部位にはセンターシャフト保 持孔5が段けられており、この保持孔5には鋳鉄 等からなるセンターシャフト6が前記ドラム本体 1の軸方向と平行となるように挿着される。この 場合、上記センターシャフト6のスラスト方向の 一端は、前記段座部4の位置まで挿入され、他端 は前記ドラム本体1の側面から突出するものとな っている。7は前記ドラム本体1の側面に媒合等 によって固定されたリングである。8は一体化さ れた前記ドラム本体1. センターシャフト保持部 材3およびリング7に対し、前記ドラム本体1の 軸方向に設けられた用紙固定用スリットである。

次に、第1図および第2図に示す紙巻付用ドラ ムの製造方法について説明する。先ず、プラスチ ックあるいはアルミニウムを原料にして成形等の 手法によってドラム本体1を形成する。そして、 このドラム本体1に対し、ドラム本体1の外周面 を基準として内周面両側に所定幅にわたって切削 加工を施し、切削部2を形成する。また、前記ド ラム本体1と同様の原料を利用して成形等の手法 によってセンターシャフト保持部材3を形成し、 このセンターシャフト保持部材3の中心部位に設 けられたセンターシャフト保持孔5にセンターシ ャフト6を揮替する。この場合、センターシャフ ト6のスラスト方向の一端がセンターシャフト保 持部材3の一端と同一平面になるまで挿入する。 センターシャフト6をセンターシャフト保持部材 5に挿着したならば、上記センターシャフト保持 部材3に対し、センターシャフト6を基準として 保持部材3の外周面に切削加工を施す。この場合、 センターシャフト保持部材3の外径が前記ドラム 本体1の切削部位における内径とほぼ同一となる

ようにする。次に、上記センターシャでは、 が3を前記ドラム体1の内周面に形成ますでは、 の内の内ののででは、 の内ののでででは、 の内ののででででは、 の内ののででででは、 の内ののででででは、 の内ののででででは、 の内ののででででは、 の内のででででする。 の内のでででする。 の内のででは、 の内のでででする。 の内のでは、 の内のでは、 の内のでは、 の内のでは、 の内のでは、 の内のでは、 ののでは、 ののでは

このような工程によって製造された用紙巻付用ドラムにおいては、ドラム本体1の外周面の切割2を製力であると共に、中心部位に設けられたセンターシャフト6を基準としてセンターシャフト保持部材3を設合させているのでは、中の外周面を切削が3を設合させているのが多くでの外周面とセンターシャフト6との特度は、嵌合寸法の精度および切削が1000円の特度は、破合寸法の特度および切削が1000円の場合では、破合す法の特度が100円にあることを表する。

なお、本発明は前記実施例に限定されるものではない。たとえば前記実施例では、センターシャフト保持孔5に挿着した後フト6をセンターシャフト保持部材3の外周面を切削加工する場合を示したが、センターシャフト保持部材3の外周面を切削加工した後、センターシャフト6を押着するようにしてもよい。このほか本発明の要旨を越えない範囲で種々変形実施可能であるのは勿論である。

(発明の効果)

本発明によれば、ドラム本体と、このドラム本

また、本発明によれば、ドラム本体の内周面をこのドラム本体の外径部を基準として両側面からそれぞれ所定幅にわたって切削すると共に、中心にてセンターシャフトを保持するセンターシャフト保持部材の外周面をセンターシャフト保持部材を前して切削し、このセンターシャフト保持部材を前記ドラム本体の内周面に設けられた切削部に嵌合

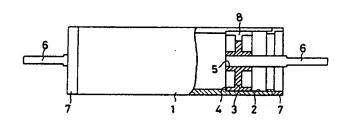
させて一体化した後、この一体化されたドラム本体とセンターシャフト保持部材との軸方向に用紙固定用スリットを形成するようにしたので、ドラム外周面とセンターシャフトとの寸法精度の向上をはかり得、回転時に偏心等によるプレが生じるおそれがない上、工程が簡単で製造コストを低減できる用紙巻付用ドラムの製造方法を提供できる。4. 図面の簡単な説明

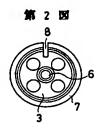
第1図および第2図は本発明の一実施例における用紙巻付用ドラムの部分断面図および側面図である。

1 …ドラム本体、2 …切削部、3 …センターシャフト保持部材、4 …段差部、5 …センターシャフト保持孔、6 …センターシャフト、7 …リング、8 …用紙固定用スリット。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

统 1 80





Docket # #1-780

Applic. # 10/695, 365

Applicant: Blöhdorn

Lerner Greenberg Stemer LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101